

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-012

江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司继续投资建设 年产100万平米芯片板级封装载板项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称:年产100万平米芯片板级封装载板项目
- 项目公司:江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北通格微电路科技有限公司(以下简称“湖北通格微”)
- 项目建设内容:本项目由湖北通格微公司作为实施主体,通过新建厂房69,120.00㎡,购置一批先进设备,建设玻璃基板芯片板级封装载板自动化生产线,形成具备规模效应的封装载板产线,项目建设期为24个月。本项目实施建成后,将实现年产100万平米玻璃基板芯片板级封装载板产能。
- 投资金额:项目总投资金额预计为人民币121,564.23万元,其中建设投资86,021.23万元,铺底流动资金35,543.00万元。截至目前,该项目已投入资金为11,784.55万元,该项目后续所需投资金额预计为109,779.68万元,拟由公司全资子公司湖北通格微继续投资建设。

本次项目投资不构成关联交易,不属于重大资产重组,本次项目投资事项尚需提交公司董事会审议。

相关风险提示:本次对外投资符合公司业务发展规划及集团公司战略发展方向,项目实施过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产、项目管理等风险,公司将积极主动关注宏观经济环境和行业政策调整变化,实施有效的内部控制和风险防范机制,确保本项目的顺利开展。

公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步实现公司业务及产品转型升级,充分利用现有TGV核心技术优势,积极布局玻璃基板导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域,以进一步丰富公司的产品体系,优化产品结构,同时推动半导体封装材料及封装技术的迭代升级。公司与湖北天门市高新技术产业开发区于2022年6月17日共同出资设立湖北通格微公司,用于投资建设“年产100万平米芯片板级封装载板项目”。详见公司于2022年6月21日于上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司关于与湖北天门市高新技术产业开发区共同出资设立合资公司及累计对外投资的公告》(公告编号:2022-068)。

鉴于公司已近期收购完成湖北天门市高新投持有的湖北通格微70%股权,并已办理完成工商交割相关手续,截至目前湖北通格微已由公司参股公司变更为全资子公司,其作为“年产100万平米芯片板级封装载板项目”的实施主体,该项目总投资金额预计为人民币121,564.23万元,其中建设投资86,021.23万元,铺底流动资金35,543.00万元。截至目前,该项目已投入资金为11,784.55万元,该项目后续所需投资金额预计为109,779.68万元。

湖北通格微作为公司全资子公司后续对该项目的继续投入,拟全额纳入上市公司合并层面,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,上述项目后续建设投入达到公司董事会和股东大会审议标准。

(二)董事会审议情况

2024年3月4日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目的议案》,同意全资子公司湖北通格微继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目。本次议案尚需提交公司董事会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营层管理办理本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

(三)其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

公司名称:湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码:91429006MAB0HL4U1U

成立时间:2022年06月17日

注册地址:湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园(西湖路317号)

法定代表人:刘松林

注册资本:12000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;新材料技术研发;集成电路芯片设计及服务;半导体器件专用设备制造;以自有资金从事股权投资;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:沃格光电持有100%股权。

主要财务数据:

项目名称	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
总资产	13,020.69	3,506.32
负债总额	1,407.04	96.90
净资产	11,613.64	3,409.42
营业收入	413.00	48.00
利润总额	-396.79	-190.68
净利润	-396.79	-190.68

上述财务数据已经天健会计师事务所(具有从事证券、期货业务资格)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、投资标的基本情况

项目名称:年产100万平米芯片板级封装载板项目

项目公司:湖北通格微电路科技有限公司

项目地点:湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园(西湖路317号)

投资金额:项目总投资金额预计为人民币121,564.23万元,其中建设投资86,021.23万元,铺底流动资金35,543.00万元。

项目建设内容:本项目由湖北通格微公司作为实施主体,通过新建厂房69,120.00㎡,购置一批先进设备,建设自动化程度较高的芯片板级封装载板产线,形成具备规模效应的封装载板产线,项目建设期为24个月。本项目实施建成后,将实现年产100万平米芯片板级封装载板产能。

截至目前项目进展顺利,截至目前该项目主体厂房已完成封顶,正在进行净房装修,同时相关设备采购工作正在同步进行,预计今年下半年进入一期正式量产阶段。随着相关资金的到位,将有助于项目建设进度的顺利实施和产能的顺利投放。

四、项目投资的必要性与可行性

(一)项目投资建设背景及必要性

本次项目投资由公司自主研发的TGV技术为基础,该技术通过叠加上司所拥有的玻璃基薄化、双面多层铜箔线路板、绝缘膜材以及巨量通孔等工艺和材料开发技术能力,聚焦玻璃基板在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用。目前,在玻璃基板半导体先进封装载板产品方面,公司多个项目已获得客户验证通过,并具备量产可行性;在新一代半导体显示方面,随着公司TGV工艺技术能力的突破,公司与国内知名企业联合发布了全球首款玻璃基TGV Micro LED显示屏,该产品使用公司推出的玻璃基TGV载板,推动了Micro LED显示的高商用化程度,目前该产品已进入量产推广和应用阶段。

从行业发展趋势和方向看,为持续延续摩尔定律,提升芯片性能和算力,玻璃基有望成为下一代新型半导体封装材料,其相较于硅基有机基板材料,其在光学、电学、热稳定性、机械强度、成本以及低功耗等方面均具有更好的表现,其在先进封装、人工智能、物联网、数码相机、微机电系统以及二维集成等领域以及新一代半导体显示Micro LED显示等高端显示领域具有广泛应用空间。据相关行业公开信息,众多国内外知名企业陆续宣布开发半导体封装玻璃基板,推动行业上下游产业链的协同推进,TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的渗透率有望进一步提升。

(二)项目建设的可行性

公司目前已具备项目继续建设的可行性进行论证,在该新产品新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面已经超前进行了布局和筹划。

人才储备:公司通过现有TGV技术核心团队,以及产品及项目管理、自动化产线搭建等核心团队,组建专业团队,同时加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养,扩大团队规模,积极拓展相关业务。

技术储备:公司与现有的玻璃基薄化、玻璃基双面多层铜箔线路板、绝缘膜材以及巨量通孔等工艺和材料开发技术能力为支撑,通过公司多年玻璃基薄化以及新材料的研发实力、多学科核心技术团队及全产业链能力,保障项目的顺利实施、投产。

市场拓展:为加快推动本次项目新建产能量产落地,打造行业知名品牌,公司引入了海内外专业市场推广方,凭借其在市场以及对公司产品的深刻认知,积极开拓市场。

资金安排:本次项目总投资金额预计为人民币121,564.23万元。截至目前,该项目已投入资金为11,784.55万元。该项目后续所需投资金额预计为109,779.68万元。资金来源为自有或自筹资金,目前该项目总产能规划的主体厂房已完成封顶,产能搭建将按照市场情况分期投入,公司已提前做好相关资金规划,并将按照项目资金实际需要分批落实到位。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略规划和产业布局,符合行业发展趋势和方向,有利于加快推动公司玻璃基TGV技术在半导体先进封装以及新一代半导体显示等产品的市场推广以及产业合作力度,增强公司的核心竞争力,符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金,并将按照项目资金实际需求分批落实到位,不影响公司现有主营业务的正常开展,公司将根据项目运营及市场情况,审慎规划总体经营投资方案,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。随着项目的投资运营,将提高公司市场竞争力,提升公司盈利能力。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司业务发展规划及集团公司战略发展方向,项目实施过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产、项目管理等风险,公司将积极主动关注宏观经济环境和行业政策调整变化,实施有效的内部控制和风险防范机制,确保本项目的顺利开展。

公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-013

江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司申请银团项目贷款及 公司对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:湖北通格微电路科技有限公司(以下简称“湖北通格微”)、宝昂电子(香港)有限公司(以下简称“香港宝昂”)。本次担保是对江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“沃格光电”)合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次子公司申请银行贷款情况:为满足子公司项目建设资金需要,公司子公司湖北通格微拟向有关银行申请总额不超过人民币50,000万元的银团项目贷款,具体融资金额以实际发生为准,上述银行贷款的申请期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
- 本次拟为子公司提供担保总额及已实际为其提供的担保金额:公司拟为湖北通格微银行贷款提供最高不超过人民币50,000万元的担保,同时拟为香港宝昂材料采购货款支付提供不超过600万美元担保。截至本公告披露日,公司为上述被担保人已经实际提供的担保金额为0元。
- 本次担保是否涉及反担保:香港宝昂其他少数股东青岛嘉昂企业管理服务合伙企业(有限合伙)拟根据其持有香港宝昂49%的持股比例为公司本次为香港宝昂提供的担保提供反担保,担保方式为保证担保。
- 对外担保期限的累计数量:无。
- 本次事项尚需提交公司董事会审议。
- 一、授信及担保情况概述

(一)本次申请银行授信情况概述

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的议案》。为满足前期建设投入和项目投资资金需求,董事会同意全资子公司湖北通格微拟向中国工商银行湖北省武汉市分行、中国工商银行江西新余分行高新支行及他行申请银团项目贷款不超过人民币50,000万元,其中中国工商银行湖北省武汉市分行支行贷款不超过2,500.00万元、中国工商银行江西新余分行高新支行贷款不超过12,500.00万元,其他成员单位中至少应包含一家四大国有商业银行,金额不低于1亿元/贷款不低于15,000.00万元,授信额度等于或融资金额,具体融资金额以实际发生为准。

上述综合授信借款的申请期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年,在此额度范围及授信期限内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于开展上述工作的开展,公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

(二)本次担保情况概述

1.为湖北通格微银团项目贷款提供担保

为保障子公司项目建设以及业务发展需要,满足其融资需求,公司为全资子公司湖北通格微本次申请的银团项目贷款提供不超过人民币5亿元担保,提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押,且为连带责任担保,担保金额以实际发生的金额为准。

2.对香港宝昂提供担保

公司控股子公司香港宝昂拟向SK microworks solutions购买TPF、BPF膜材,并在客户端持续争取订单,香港宝昂作为公司向间接持股51%股权的下属控股子公司,其将严格按照北京宝昂电子有限公司(以下简称“北京宝昂”)与SK microworks solutions签署的《Memorandum of Understanding》及其与SK microworks solutions 签署的相关订单内容,按时支付货款。

基于公司控股子公司北京宝昂及香港宝昂未来的交易规模,为满足香港宝昂日常经营活动的需要以及争取订单的需要,公司拟为香港宝昂提供最高额不超过600万美元的支付担保额度。若香港宝昂未按照SK microworks solutions签订的相关文件付款,公司将按照连带责任保证。同时,香港宝昂其他少数股东青岛嘉昂企业管理服务合伙企业(有限合伙)将根据其持有香港宝昂49%的持股比例为公司上述担保提供反担保,担保方式为保证担保。

一、被担保人基本情况

1.湖北通格微电路科技有限公司

公司名称:湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码:91429006MAB0HL4U1U

成立时间:2022年06月17日

注册地址:湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园(西湖路317号)

法定代表人:刘松林

注册资本:12000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;新材料技术研发;集成电路芯片设计及服务;半导体器件专用设备制造;以自有资金从事股权投资;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:沃格光电持有100%股权。

主要财务数据:

项目名称	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
总资产	13,020.69	3,506.32
负债总额	1,407.04	96.90
净资产	11,613.64	3,409.42
营业收入	413.00	48.00
利润总额	-396.79	-190.68
净利润	-396.79	-190.68

注:上述财务数据已经会计师事务所审计。

二、宝昂电子(香港)有限公司

公司名称:宝昂电子(香港)有限公司

公司编号:3076393

成立时间:2021年8月13日

注册地址:香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室

法定代表人:于光

注册资本:1,000万美元

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:国际贸易、投资

股权结构:香港宝昂为沃格光电持股51%的控股子公司北京宝昂电子有限公司的全资子公司,公司间接持有香港宝昂51%股权,青岛嘉昂企业管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有香港宝昂49%股权,香港宝昂实际为公司下属控股子公司。

主要财务数据:

项目名称	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
总资产	1,779.03	684.79
负债总额	1,031.20	113.86
净资产	1,296.79	570.23
营业收入	3,022.82	1,193.89
利润总额	804.89	346.69
净利润	665.83	272.23

三、担保协议的主要内容

1.湖北通格微银团项目的担保协议的主要内容

(1) 借款人:债权人;中国工商银行湖北省武汉市分行、中国工商银行江西新余分行高新支行及他行成员单位中至少应包含一家四大国有商业银行,金额不低于1亿元

保证人:江西沃格光电股份有限公司

受信人:湖北通格微电路科技有限公司

(2) 担保最高金额:人民币2.25亿元、人民币1.25亿元、人民币1.5亿元

(3) 保证方式:连带责任保证

(4) 担保范围:担保范围:根据本协议约定属于本合同担保的主债权的,沃格光电担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、罚息、滞纳金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费)。

(5) 保证期间:自审批后的借款合同生效,初步确定为6年。

注:公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,上述担保总额、担保银行及担保期限均以公司拟提供的担保额度、担保银行和期限,具体担保金额、银行和担保期限以实际签署的合同为准。

2.香港宝昂拟签署的担保协议的主要内容

(1) 债权人:SK microworks solutions

保证人:江西沃格光电股份有限公司

被担保人:宝昂电子(香港)有限公司

(2) 担保额度:600万美元

(3) 保证方式:连带责任保证

(4) 保证担保范围:香港宝昂拟向SK microworks solutions购买TPF、BPF膜材,并在客户端持续争取订单,香港宝昂将严格按照北京宝昂与SK microworks solutions 签署的《Memorandum of Understanding》及其与SK microworks solutions 签署的相关订单内容,按时支付货款。

基于公司子公司北京宝昂及香港宝昂未来的交易规模,公司拟为香港宝昂提供最高额不超过600万美元的支付担保额度。若香港宝昂未按照SK microworks solutions签订的相关文件付款,公司将承担连带保证责任。

(5) 保证期间:自2024年12月31日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司湖北通格微银行贷款提供担保有利于提升其融资能力,加快湖北通格微新建项目的投资建设进度和新业务的开展,符合公司整体发展战略和公司整体利益。

公司拟为香港宝昂材料采购的支付提供担保主要为其日常经营活动的顺利开展,有利于持续争取核心客户订单,符合公司整体发展战略和公司整体利益。本次香港宝昂作为被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对经营管理、财务等方面具有控制权,同时,香港宝昂其他少数股东青岛嘉昂企业管理服务合伙企业(有限合伙)将根据其持有香港宝昂49%的持股比例为公司上述担保提供反担保,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等相关规定,被担保方为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有实质控制权,资信状况良好,担保风险可控,公司为其提供担保不会损害公司的利益。本次为控股子公司提供担保事项系考虑对被担保方为公司控股子公司,且子公司资信和经营情况良好,有能力对其经营管理风险进行控制,且控股子公司其他少数股东提供了相应的反担保。上述担保风险可控,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保授信总额为87,300万元人民币和300.77万美元,上市公司已实际提供的担保金额为51,300万元人民币(均为对合并报表内子公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.29%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-009

江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知,公司已于2024年2月28日以书面方式和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘伟先生召集,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)审议通过《关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加注册资本的议案》

本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加注册资本的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目的议案》

鉴于公司已近期办理完成湖北通格微电路科技有限公司70%股权转让交割事项,截至目前湖北通格微已由公司参股公司变更为公司全资子公司,其作为“年产100万平米芯片板级封装载板项目”的实施主体,后续该项目的投入拟全额纳入上市公司合并范围。根据该项目年产100万平米总投资额度规划,项目总投资金额预计为人民币121,564.23万元,截至目前项目已投入总金额为11,784.55万元,该项目后续所需投资金额预计为109,779.68万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,上述项目后续建设投入达到公司董事会和股东大会审议标准。

本议案具体内容以及本次继续投资建设项目的目的和意义以及目前相关进展详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。本议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2024年3月5日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-010

江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日以通讯方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2024年2月28日以书面方式和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席刘伟先生召集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)审议通过《关于全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目的议案》

本议案具体内容以及本次继续投资建设项目的目的和意义以及目前相关进展详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于全资子公司继续投资建设年产100万平米芯片板级封装载板项目的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会
2024年3月5日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-011

江西沃格光电股份有限公司 关于向全资子公司湖北通格微电路科 技有限公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:湖北通格微电路科技有限公司(以下简称“湖北通格微”)

● 投资金额:江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”、“沃格光电”)拟以自有资金向全资子公司湖北通格微增资人民币1.8亿元。本次增资完成,湖北通格微注册资本将由人民币3亿元变更为人民币4.8亿元。

● 本次投资不涉及与关联方交易,也不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:本次对外投资系公司从长期发展战略布局出发的慎重决定,在实际经营过程中,可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,公司将实施有效的内部控制和风险防范机制,加强对子公司的管理,监督项目实施建设,积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加快湖北通格微年产100万平米玻璃基板芯片板级封装载板项目建设进度,根据项目建设的实际需要,经公司审慎决策并经公司董事会审议通过,公司拟以自有资金向湖北通格微增资人民币1.8亿元。本次增资完成后,湖北通格微的注册资本由1.2亿元变更为人民币3亿元,公司仍持有湖北通格微100%股权。

(二)董事会审议情况

公司于2024年3月4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则